证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-011

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源、重阳投资、西部证券、诺鼎资产、银叶投资、银华基金、宁银理财、伟星资管、华安合鑫、中海基金、长江证券、国君资管
时间	2025年10月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、下游应用领域营收及增速情况和后续展望？ AIoT 营收占比接近 70%，上半年整体增速在 30% 左右，AIoT 领域目前处于“创新驱动”周期，AI 驱动下新应用场景渗透率提升，下游需求预计将会持续增长；PA 营收占比约为 10%，后续重心以 PAMiF 及 PAMiD 模组类产品为主；安防营收占比约为 10%，整体增速平稳；运算和车规产品营收合计占比 10%左右，未来随着国内车规设计公司的发展以及海外车规大厂本土化布局战略的推进和 AI 发展对运算类芯片的需求，预计运算和车规领域的增速较快，营收占比将会持续提升。 2、2.5D 封装进展？ 公司 2.5D 封装产线于 2024 年四季度通线，目前正在和相关客户做产品验证。但由于 2.5D 封装产品工艺复杂，验证周期较长，实现稳定量产需要一定时间。

	3、今年的折旧情况？ 2025 年全年折旧的绝对金额预计相比 2024 年仍会上涨。 4、价格变动趋势？ 目前封测行业价格处于相对稳定的状态，但在产能饱和情况下客户可能会出于缩短交期目的而主动溢价。 5、公司车规领域主要做哪些产品？ 公司在车规领域主要做车载 CIS 及激光雷达等产品。 6、晶圆级封装产品情况？ 公司晶圆级封装的稼动率不断提高，毛利率环比逐季度改善，后续随着大客户相关产品的导入，稼动率水平有望提升，促进毛利率转正。 7、研发支出未来变动趋势？ 公司专注于中高端先进封装，围绕先进封装领域，研发投入持续提升，研发费用率将会维持在 6%左右的水平。 8、一期和二期稼动率情况？ 一期工厂整体稼动率处于满产状态；二期工厂中 FC 和 QFN 等成熟产线处于满产状态，Bumping 和 WLP 等先进封装产线稼动率还在持续爬坡中。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 10 月 10 日

注:公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流,如涉及公司战略规划等意向性目标,不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺,敬请广大投资者注意投资风险。